INJECTION MOLDING DEVICE

Patent Number:

JP7276437

Publication date:

1995-10-24

Inventor(s):

SAKAI YUMI; others: 01

Applicant(s):

TDK CORP

Requested Patent:

JP7276437

Application Number: JP19940095453 19940411

Priority Number(s):

IPC Classification:

B29C45/26; B29C45/73; G11B7/26

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To economize a molding resin material for a molded piece by eliminating a sprue and a runner in an injection molding machine which molds a molded piece having a center axis hole, and to largely reduce the cost by eliminating a post processing.

CONSTITUTION:In a hot runner 13, a fixed mold 11 and a movable mold 12 are provided with a fixed pin 1 and a movable pin 2 which are respectively connected to driving sections 3 and 4 arranged oppositely, separably and slidably. At the tip of the fixed pin 1, a flange 7 having a large diameter is arranged so as to open/close a gate of a cavity 10. Thus, the tip faces of the pins 1 and 2 are fitted and abutted separably by conical or spherical irregular faces 5 and 6, so that a sprue and a runner are replaced by the sliding pins for opening/closing the gate. As a result, the cost of a molding resin material for a molded piece can be reduced, a molded piece having excellent quality without deviation of core can be manufacture with excellent productivity; abrasion and scuff of the molds do not occur, and the cost for maintaining the molds can be largely reduced.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-276437

(43)公開日 平成7年(1995)10月24日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			ŧ	支術表示	簡所
B 2 9 C	45/26		7415-4F						
	45/73		7639-4F						
G11B	7/26	5 2 1	7215-5D						
# B29L	17: 00								
				宏本詩	李韓 泰	請砂頂の数り	ΕD	(全 5	(百)

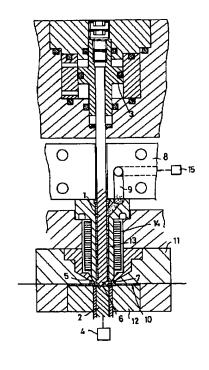
(21)出願番号	特顧平6-95453	(71)出願人	000003067
			ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)4月11日		東京都中央区日本橋1丁目13番1号
		(72)発明者	坂井 由美
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者	小山 敦
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 薬師 稔

(54) 【発明の名称】 射出成形装置

(57)【要約】

【目的】中心軸穴のある成形品を成形する射出成形にス ブルー、並びにランナーをなくして成形品に対する成形 樹脂材料を節減し、後加工もなくして大巾なコストダウ ンを図る。

【構成】前記ホットランナー13内において、固定側金 型11と可動側金型12とにそれぞれ駆動部3,4に連 結された固定側ピン1と可動側ピン2とを接離自在で摺 動可能に対設し、該固定側ピン1の先端部に大径のフラ ンジ部7を備えてキャピティ10のゲートを開閉するよ うにすると共に、両ピン1,2の先端面を錐面或いは球 面の凹凸面5,6で接離自在に嵌合当接配備したこと で、ゲートを開閉する摺動ピンでスプルー、並びにラン ナーを無くして成形品に対する成形樹脂材料のコストダ ウンを図り、芯ずれもなく品質良好な成形品を生産性よ く製造でき、成形金型の摩耗やカジリ等の発生もなく金 型維持コストも大巾に低減できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固定側金型と可動側金型との間に形成さ れるキャピティに連通するホットランナー内に摺動自在 に設けられたピンでゲートを開閉する射出成形装置にお いて、固定側金型と可動側金型とにそれぞれ駆動部に連 結された固定側ピンと可動側ピンとを接離自在で摺動可 能に対設し、該固定側ピンの先端部に大径のフランジ部 を備えてキャピティのゲートを開閉するようにすると共 に、両ピンの先端面を錐面或いは球面の凹凸面で接離自 在に嵌合当接配備したことを特徴とする射出成形装置。

前記可動側ピンが、前記固定側ピンの移 動に追随して移動するものであって、型開き時点まで固 定側ピンと当接状態に配備された請求項1記載の射出成 形装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスク或いは光磁 気ディスクなどのディスク基板のような中心軸穴、その 他中央開口部のある成形品を成形するための射出成形装 置、特に成形時に発生するスプルー、並びにランナーを 20 なくした状態で製品化できるよう改良された射出成形装 置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、中心軸穴等の開口部のある成形品 は、金型も構造上キャピティに溶融樹脂を注入するゲー トは、中心軸穴等開口部を避けて通常数点ゲートで設け るか、ディスク基板のような場合、中心軸穴等開口部を 使用してディスクゲートを設け、後で軸穴等開口部を機 械加工で製作する方法が主流であって、この形態で生産 されていることが多い。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、この中心軸 穴等開口部を避けて数点ゲートを設けた場合では、その 成形品が、ギア、光学ディスクなど真円度等の寸法精度 を要求される場合、或いは樹脂の合流部であるウエルド の存在が許されない場合は使用出来ない。このため、デ ィスク基板の成形に多用されているディスクゲートで は、寸法精度は数点ゲートより向上し、ウエルドも発生 しないが、機械加工の工程が増え加工コストが上昇する 欠点があった。また、ディスクゲートの代わりに中心軸 40 穴等閉口部より樹脂を注入するホットランナーの事例、 例えば図5のように成形品Cのためのゲートを開閉の動 作をする摺動可能なピンAが同時に中心軸を形成する構 造では、そのピンAが金型の可動側の穴部Bに金型の開 閉動作毎に嵌合させなければならない。一方、金型でピ ンのある固定側と嵌合穴Bのある可動側は、それぞれ成 形機の固定プラテン、可動プラテンに固定され、金型開 閉時にその芯が精度良く一致する事は非常に困難であ る。よって、ピンA或いは嵌合穴Bの摩耗、カジリが発 生して問題があり、また図6のように成形品Cのための 50 て、このゲートより溶融された樹脂が、金型キャビティ

ゲートを開閉する金型固定側の摺動可能なピンAが、金 型可動側の嵌合穴Bと金型開閉動作毎に嵌合するように しても、前例の不具合が発生するので問題があった。ま た、スプルーをなくして製品に対する材料費のコストダ ウンを図るスプルーレスの成形装置が提案されている (特開平5-212757号公報)が、成形後に成形品 とランナーが取り出されランナーは、廃棄されることに よりコストアップの要因となるし、摩耗やカジリによっ てギャップ発生を修正するための金型部品加工コストや 10 製作期間の面で不利となるばかりか、金型の維持コスト も高くなるなどの欠点がある。本発明は、これら従来の 諸欠点を解決しようとするもので、中心軸穴などのある 成形品を成形する際に、ゲートを開閉する摺動ピンでス プルー、並びにランナーを無くして成形品に対する成形 樹脂材料のコストダウンを図り、芯ずれもなく品質良好 な成形品を生産性よく製造でき、成形金型の摩耗やカジ リ等の発生もなく金型維持コストも大巾に低減できる射

[0004]

たものである。

【課題を解決するための手段】本発明は、固定側金型と 可動側金型との間に形成されるキャピティに連通するホ ットランナー内に摺動自在に設けられたピンでゲートを 開閉する射出成形装置において、固定側金型と可動側金 型とにそれぞれ駆動部に連結された固定側ピンと可動側 ピンとを接離自在で摺動可能に対設し、該固定側ピンの 先端部に大径のフランジ部を備えてキャビティのゲート を開閉するようにすると共に、両ピンの先端面を錐面或 いは球面の凹凸面で接離自在に嵌合当接配備したもので 30 ある。

出成形装置を構成簡単で安価に提供することを目的とし

[0005]

【作用】光ディスク基板の成形の例で説明すると、溶融 樹脂材料が樹脂流路を経由してキャピティに対して注入 され、特に、金型の型締したのち、ノズルから溶融樹脂 を射出すると、射出された溶融樹脂は保温された金型内 に流過し、更に通電により加熱保温されたホットランナ ーを通過してゲート開の時にキャピティの中心から半径 方向に広がるラジアルフローで均一に充填される。即 ち、ホットランナー内に摺動する固定側、可動側ピンに よって、キャピティのゲートの開閉が行われるが、この 固定側、可動側ピンは、金型が閉じた状態では、各々の 先端で接しているか、或いは隙間がある状態で固定側、 可動側ピンの先端は接すると、テーパー等でお互いの芯 が合う構造となっていて、溶融樹脂の射出開始時に固定 側のピンが前進し、可動側のピンに接し、2本のピンの 芯が合った状態で固定側のピンが更に前進し、可動側の ピンが後退する。前進した固定側のピンは後退した可動 側のピンの穴に嵌合される。同時に固定側のピンと金型 キャピティとの隙間で樹脂を注入するゲートが形成され (3)

3

に注入され、所定時間経過後、可動側のピンが前進し同 時に固定側のピンが後退し、固定側のピンによりゲート を閉じる操作を繰り返し、スプルー並びにランナーをな くした状態で品質良好な光ディスク基板の製品を低コス トで生産することができる。

[0006]

【実施例】本発明の実施例を、図1及び図2の例におけ る光ディスク基板の成形金型で説明すると、固定側金型 11と、これに対設される可動側金型12とからなる成 のキャピティ10に連通する溶融樹脂注入用の中心軸穴 となるホットランナー13を通電加熱手段、例えばヒー ター14を備えて設け、成形機ノズル15により、ホッ トランナー内の樹脂を加圧しつつ供給してキャピティ1 0に溶融樹脂を充填して、光ディスク基板を成形できる ようにしてあって、前記ホットランナー13内におい て、固定側金型11と可動側金型12とにそれぞれ駆動 部3,4に連結された固定側ピン1と可動側ピン2とを 接離自在で摺動可能に対設し、該固定側ピン1の先端部 を開閉するようにすると共に、両ピン1,2の先端面を 錐面或いは球面の凹凸面5,6で接離自在に嵌合当接配 備して光ディスク基板用の射出成形装置としてある。

【0007】前記固定側ピン1としては、溶融樹脂を注 入する前記ホットランナー13の中心軸穴に同心に貫通 された中心軸であって、後端に駆動シリンダの駆動部3 を備え、キャピティ10のゲートを開閉動作するもの で、その先端に前記キャピティのゲートを開閉しうる大 径のフランジ部7を備え、該フランジ部7と等径の可動 側ピン2とに接離自在に当接してある。

【0008】この固定側および、可動側のピン1、2 は、金型が閉じた状態では、各々の先端で接している か、或いは隙間がある状態で、固定側、可動側ピン1. 2の先端は接すると、テーパー等でお互いの芯が合う凹 凸面 5, 6 の嵌合構造をとなっていて、溶融樹脂の射出 開始時に固定側ピン1が前進し、可動側ピン2に接し、 2本のピン1, 2の芯が合った状態で固定側ピン1が更 に前進し、可動側ピン2が後退する。前進した固定側ピ ン1は後退した可動側ピン2の穴に嵌合されて、同時に 固定側ピン1とキャピティ10との隙間で樹脂を注入す 40 るゲートが形成されて、このゲートより溶融された樹脂 が、キャピティ10に注入され、所定時間経過後、可動 側ピン2が前進し同時に固定側ピン1が後退し、固定側 ピン1によりゲートを閉じる操作を繰り返し、スプルー 並びにランナーをなくした状態で品質良好な光ディスク 基板を生産することができる。

【0009】なお、前記ホットランナー13が、マニホ ールドに形成された溶融樹脂流路9に連通され、ヒータ -14などの加熱手段により加熱される中心軸穴を有し て固定側金型11に備えられるものであって、可動側金 50

型12に備えられる可動側ピン2の中心軸穴に対設され ていて、この可動側ピン2は、前記固定側ピン1の移動 に追随して移動しキャピティ10のゲートを閉じるもの であって、型開き時点まで固定側ピン1と当接状態に配 備されている。

【0010】図3及び図4の例では、前記ホットランナ -13の先端部に大径穴16を形成して、該大径穴16 に固定側ピン1の先端のフランジ部7が装入されて移動 できるようにしたもので、可動側ピン2の当接時に、溶 形金型内に、光ディスク状キャピティ10を形成し、こ 10 融樹脂の戻りが容易で、固定側ピン1と可動側ピン2と の当接面間に樹脂残りがないようにする好適例である。

> 【0011】この場合、射出時に固定側ピン1のみが後 退し、射出後ゲートを閉じる時点で可動側ピン2が前進 しゲートを閉じ、同時に先端で芯を合わせ、金型が開く 時点までに固定側ピン1と可動側ピン2が同時に移動 し、射出前の状態にもどるようにしてスプルー並びにラ ンナーをなくした状態で光ディスク基板を量産できる。

【発明の効果】本発明は、固定側金型と可動側金型との 間に形成されるキャビティに連通するホットランナー内 に大径のフランジ部7を備えてキャビティ10のゲート 20 に摺動自在に設けられたピンでゲートを開閉する射出成 形装置において、固定側金型と可動側金型とにそれぞれ 駆動部に連結された固定側ピンと可動側ピンとを接離自 在で摺動可能に対設し、該固定側ピンの先端部に大径の フランジ部を備えてキャビティのゲートを開閉するよう にすると共に、両ピンの先端面を錐面或いは球面の凹凸 面で接離自在に嵌合当接配備したことにより、金型が閉 じた状態では固定側或いは可動側のピン共に嵌合穴に嵌 合されることはなく、摩耗、カジリ等の不具合は発生し ないし、また射出時、ゲートを閉じる時の固定側、可動 30 側のピンの嵌合穴への移動は、お互いのピンの先端で芯 が合っているため、摩耗、カジリは発生しないので、金 型維持コストが大巾に低減でき、成形作業も安全、円滑 で生産性を高められ、しかもスプルーやランナーが発生 しないために、成形品に対する材料節減が容易で、加工 後の作業もなく、コスト面より有利であり、構成も簡単 で製作容易であるなどの効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す縦断面図である。

【図2】図1の例の作動状態を示す一部の縦断面図で、

(a) は型閉工程、(b) は樹脂射出工程(ゲート 開)、(c)は冷却工程(ゲートカット・ゲート閉)を 示す。

【図3】本発明の他の実施例を示す縦断面図である。

【図4】図3の例の作動状態を示す一部の縦断面図で、

- (a) は型閉工程、(b) は射出工程(ゲート開)、
- (c) は冷却工程(ゲート閉)、(d) は冷却工程(ゲ ートカット)を示す。

【図5】従来例の一部の拡大縦断面図である。

【図6】従来例の他例の一部の拡大縦断面図である。

【符号の説明】

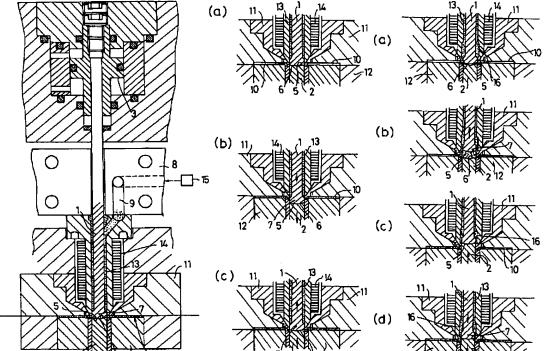
(4) 特開平7-276437

5 1 固定側ピン 10 キャピティ 2 可動側ピン 11 固定側金型

3, 4 駆動部 12 可動側金型 5, 6 凹凸面 13 ホットランナー 7 フランジ部 14 ヒーター

8 マニホールド 15 成形機ノズル 9 溶融樹脂流路

【図1】 [図2] 【図4】 (a) (a)



【図5】 [図6]

【図3】

